

# Effect of Heat Treatment on Superconducting Properties on Bi2212/Ag Wire

S. C. Kim<sup>\*a,c</sup>, D. W. Ha<sup>b</sup>, K. J. Song<sup>b</sup>, S. S. Oh<sup>b</sup>, N. J. Lee<sup>b</sup>, I. Y. Han<sup>a</sup>,  
J. G. Oh<sup>b</sup>, H. S. Sohn<sup>c</sup>

<sup>a</sup> *Nexans Korea Ltd., Chungbuk, Korea*

<sup>b</sup> *Korea Electrotechnology Research Institute, Changwon, Korea*

<sup>c</sup> *Kyungpook National University, Daegu, Korea*

Received 11 August 2006

## Bi2212/Ag 선재의 초전도 특성에 대한 열처리의 영향

김상철<sup>\*a,c</sup>, 하동우<sup>b</sup>, 송규정<sup>b</sup>, 오상수<sup>b</sup>, 이남진<sup>b</sup>, 한일용<sup>a</sup>, 오재근<sup>b</sup>, 손호상<sup>c</sup>

### Abstract

We have fabricated double stacked 385 filamentary Bi2212/Ag round wires which have different Ag ratios. The wires have been heat-treated at the maximum temperature( $T_{max}$ ) of 882 ~ 896 °C for 0.5 h. Effect of heat treatment on critical current density and critical temperature on Bi2212/Ag round wires has been studied. Critical current density of the wire heat-treated at 890 °C showed 206,250 A/cm<sup>2</sup> at 4.2 K, 0 T and critical temperature of the wire was 83 K. Microstructure of the wires also has been studied via optical microscopy and SEM.

*Keywords :* Bi2212 wire, Critical current density, Maximum temperature

### I. Introduction

Bi2212는 다른 초전도체와 비교하여 10 T에서 30 T까지 자장에서 매우 높은 임계전류밀도( $J_c$ )를 가진다 [1, 2]. Nb<sub>3</sub>Sn 마그넷은 상부임계자장( $B_{c2}$ )의 한계로 인해 25 T이상은 발생시키기 어려울 것으로 판단되기 때문에 Bi2212가 고자장 응용에 사용될 수 있다. Bi2212는 또한

우수한 상 안정성과 장선화에 용이하다. Bi2212 선재는 한 번의 열처리만 필요하기 때문에 Wind & React법이 사용될 수 있다. 게다가 원형 직사각형, 테일 등 다양한 형태로 제조될 수 있고 열처리 전에 리더포드 케이블과 원형연선 등으로 제조하여 대전류 통전이 가능하다 [3].

Bi2212/Ag 원형 선재는 이방성이 없는 유일한 고온초전도체이고 4.2 K에서 높은 공칭임계전류밀도( $J_c$ )와 제조비용이 저렴하다 [4]. Bi2212/Ag 원형선재는 주로 SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage), 입자가속기, NMR, 모

\*Corresponding author. Fax : +82 43 270 0374  
e-mail : sckim999@msn.com

터 그리고 발전기 등 코일의 형태로서 사용이 가능하다.

본 연구에서는 은비를 달리하여 제조된 선재에서 초전도 특성에 대해 열처리가 어떤 영향을 미치는지 조사하였다.

## II. Experimental

Nexans SuperConductor에서 melt casting법으로 제조된  $\text{Bi}_{2.17}\text{Sr}_{1.94}\text{Ca}_{0.89}\text{Cu}_{2.00}\text{O}_x$ 의 조성을 가진 전구체 분말을 사용하여 PIT법으로 다심 Bi2212/Ag 선재를 제조하였다. 분말은 Bi2212가 97.2 wt. %, Bi2201가 2.5 wt. %, CuO가 0.3 wt. %로 구성된 것으로 Rietveld법을 사용한 정량분석결과 확인되었다. 분말의 탄소량은 100 ppm 이하이고 밀도는  $2.3 \text{ g/cm}^3$ 이였고 BSCCO/Ag 혼합물을 100 %  $\text{O}_2$ 에서 DTA/TGA 측정결과 포정분해온도( $T_p$ )가  $881 \pm 2$  °C인 것으로 확인되었다.

단심용 은튜브의 두께를 조절하여 선재의 은비를 변화시켰다. 분말충진 후 단심선재의 은비를 0.3(A), 0.42(B), 0.42(C), 0.55(D), 그리고 0.72(E)로 하였다. 단심선재의 은튜브 크기는 외에는 1차 다심과 2차 다심의 은튜브 크기는 동일하게 하였다. 모든 인발공정에서 A와 B선재의 단면감소율은 10 ~ 15 %였고 C, D, 그리고 E선재는 단면감소율 20 %를 적용하였다. 55개의 단심선재를 순은 튜브에 적층하여 1차 다심을 제조하고 인발 후 7개의 1차 다심선재를 AgMg튜브에 적층하여 2차 다심을 제조한 후 1.34 ~ 0.74 mm dia. 까지 인발하였다.

열처리 전 시편의 양단은 순은 테잎으로 감싼 후 압착하였다. Bi2212 선재의 열처리는 부분용융-응고 열처리로서 2212의 포정반응(2212  $\rightarrow$  L + other phases)온도보다 높은 최대온도( $T_{\max}$ )까지 가열한 후 역 포정반응을 통해 2212를 형성한다. 100 %  $\text{O}_2$  분위기에서  $T_{\max}=882 \sim 896$  °C에서 30분간 부분용융열처리를 실시하였다. 냉각속도는 10 °C/h로 하였으며, 제2상을 소비하기 위한 어닐링을 835 °C에서 36 h동안 실시하였다.

였다.

$1 \mu\text{V}/\text{cm}$ 의 기준으로 4단자법을 사용하여 4.2 K, 0 T에서 임계전류( $I_c$ )를 측정하였고 열처리전 초전도체의 면적을 임계전류로 나누어서 임계전류밀도( $J_c$ )를 구하였으며, 임계온도( $T_c$ )는 PPMS(Physical Property Measurement System)를 이용하여 자화법으로 측정하였다. 임계전류 측정용 시편의 전체길이는 6 cm이고 전압단자간 거리는 2 cm이다. 시편의 미세조직은 70 %  $\text{NH}_4\text{OH}$ 와 30 %  $\text{H}_2\text{O}_2$ 를 12대 5의 질량비로 혼합한 용액을 사용하여 3 ~ 5초 동안 은을 에칭한 후 SEM(Hitachi S-4800)으로 분석하였다.

## III. Results and discussion

Fig. 1은  $T_{\max}$  888 °C에서 열처리된 Bi2212/Ag 0.9 mm dia.의 B선재의 단면을 나타내고 있다. 단면에서 필라멘트 간에 intergrowth가 발생하였는데 H. Miao에 의하면 Bi2212 필라멘트에서 whisker의 성장은 Sr/Ca의 비가 높을수록 많아 진다고 하였다 [5]. 본 연구에서는 Sr/Ca의 비가 2.13으로 H. Miao 논문의 2.18과 비슷한 whisker의 양을 나타내고 있다고 판단된다.

Fig. 2는  $T_{\max}$  888 °C에서 열처리된 0.81 mm dia. 선재들의  $J_c$ 를 나타낸 것이다. 은비 3.73의

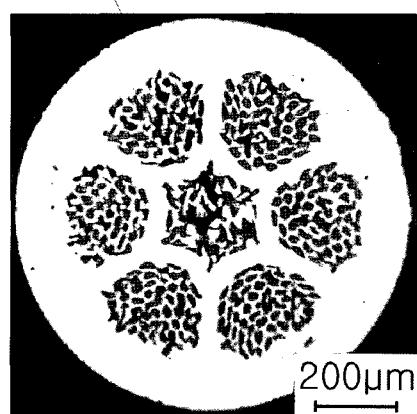


Fig. 1. Transverse cross section of 0.9 mm diameter Bi2212/Ag round wire(B wire) heat-treated at  $T_{\max} = 888$  °C.

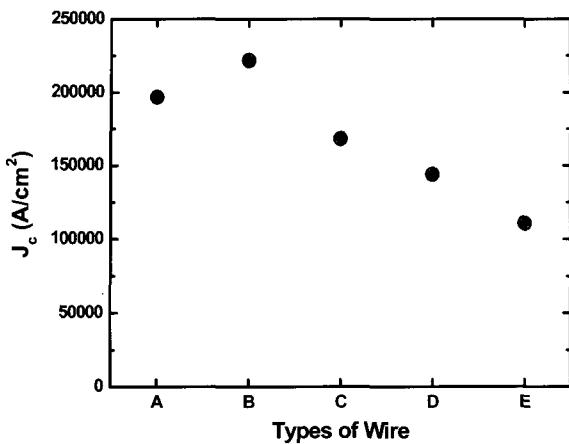


Fig. 2. Critical current density of 0.81 mm diameter Bi2212/Ag round wires heat-treated at  $T_{\max} = 888^\circ\text{C}$ .

B선재가  $221,800 \text{ A}/\text{cm}^2$ 의  $J_c$ 와  $244 \text{ A}$ 의  $I_c$ 를 나타내었다.  $10 \sim 15\%$ 의 단면감소율로 인발된 A와 B선재는 비슷한  $I_c$ 를 나타내지만 B선재의  $J_c$ 가  $13\%$  높게 나타났다. 이것은 B선재가 같은 직경에서 더 높은 은비를 가지므로 상대적으로 낮은 초전도면적에 의해 높은  $J_c$ 를 나타낸 것으로 판단된다.  $20\%$ 의 단면감소율로 인발된 선재 C, D, 그리고 E에서는 은비가 3.75에서 4.78로 증가함에 따라  $J_c$ 는 직선적으로 감소하였다. 이것은 어떤 값 이상으로 은비를 증가시키는 것은  $I_c$ 뿐 만 아니라  $J_c$ 도 감소시키는 것으로 생각된다.

Fig. 3은 0.74mm dia. B선재의  $T_{\max}$ 에 따른  $J_c$ 를 나타내고 있다.  $T_{\max}=890^\circ\text{C}$ ,  $T_{\max}=882^\circ\text{C}$ 에서 열처리된 선재의  $J_c$ 가 각각  $206,250 \text{ A}/\text{cm}^2$ ,  $13,750 \text{ A}/\text{cm}^2$ 으로서  $T_{\max}$ 가 Bi2212/Ag 선재를 제조할 때 가장 중요한 인자들 중의 하나라는 것을 알 수 있었다.  $T_{\max}=888^\circ\text{C}$ 에서 열처리된 0.9 mm dia.의 단면을 back scattered electron microscopy로 관찰하였다. Bi2212의 주요 제2상은 EDS분석으로 어두운 회색의 전류제한인자인  $(\text{Sr}, \text{Ca})_{14}\text{Cu}_{24}\text{O}_z$  14:24 AEC(Alkaline Earth Cuprate) 제2상이 몇몇 필라멘트의 중앙에서 관찰되었고 다른 부분은 Bi가 약간 증가한  $\text{Bi}_{2.38}\text{Sr}_{2.0}\text{Ca}_{0.86}\text{Cu}_2\text{O}_x$  (Bi2212) 기자라는 것을 확인했다.

B선재의 선재직경( $1.34$ ,  $1.12$ ,  $0.81$ , 그리고  $0.74 \text{ mm dia.}$ )에 따른  $J_c$ 에 대해 조사하였다. 385 필라멘트의 평균필라멘트 직경은 각각  $33.4$ ,  $25.5$ ,  $18.8$ , 그리고  $16.3 \mu\text{m}$ 였다. 평균필라멘트 직경이  $33.4 \mu\text{m}$ 에서  $16.3 \mu\text{m}$ 으로 감소함에 따라  $J_c$ 는  $85,900 \text{ A}/\text{cm}^2$ 에서  $147,700 \text{ A}/\text{cm}^2$ 으로 증가하였고  $18.8 \mu\text{m}$ 과  $16.3 \mu\text{m}$ 의 평균필라멘트 직경을 가지는 선재는 비슷한  $J_c$ 를 나타내었다. 이러한 선재 구조에서는  $18.8 \sim 16.3 \mu\text{m}$ 의 평균필라멘트 직경이  $J_c$ 측면에서  $33.4 \sim 25.5 \mu\text{m}$ 보다 유리한 것으로 생각된다.

Fig. 4는  $T_{\max}$ 를 달리한 B선재의 DC susceptibility를 나타낸 것이다.  $T_{\max}$ 가  $882^\circ\text{C}$ ,  $888^\circ\text{C}$ ,  $890^\circ\text{C}$ ,  $892^\circ\text{C}$ , 그리고  $896^\circ\text{C}$  일 때 각각  $T_c$ 가  $80 \text{ K}$ ,  $85 \text{ K}$ ,  $83 \text{ K}$ ,  $82 \text{ K}$ , 그리고  $81 \text{ K}$ 로서 많은 차이를 나타내지는 않았다.  $T_{\max}=890^\circ\text{C}$ 에서 최대  $J_c$ 를 나타내었지만  $T_c$  또한 최대값을 나타내지는 않고  $T_{\max}=888^\circ\text{C}$ 에서  $85 \text{ K}$ 로서 최대 임계온도를 나타내었다.

Fig. 5는  $0.74 \text{ mm dia.}$  선재를 열처리 후 은을 에칭하여 1차 다심 bundle부분을 관찰한 SEM 사진결과이다.  $T_{\max}=882^\circ\text{C}$  선재는 Bi-2212 결정립이 밖으로 성장하는 outgrowth가 많이 관찰되었지만  $T_{\max}=890^\circ\text{C}$ 에서는 상대적으로 적고 결정립이 더욱 길게 성장한 것으로 관찰되었다 [6].

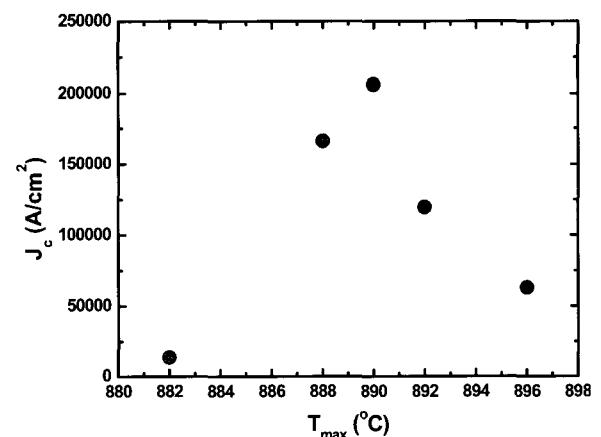


Fig. 3. Critical current density of 0.74 mm diameter B wire as a function of  $T_{\max}$  measured at  $4.2 \text{ K}$ ,  $0 \text{ T}$ .

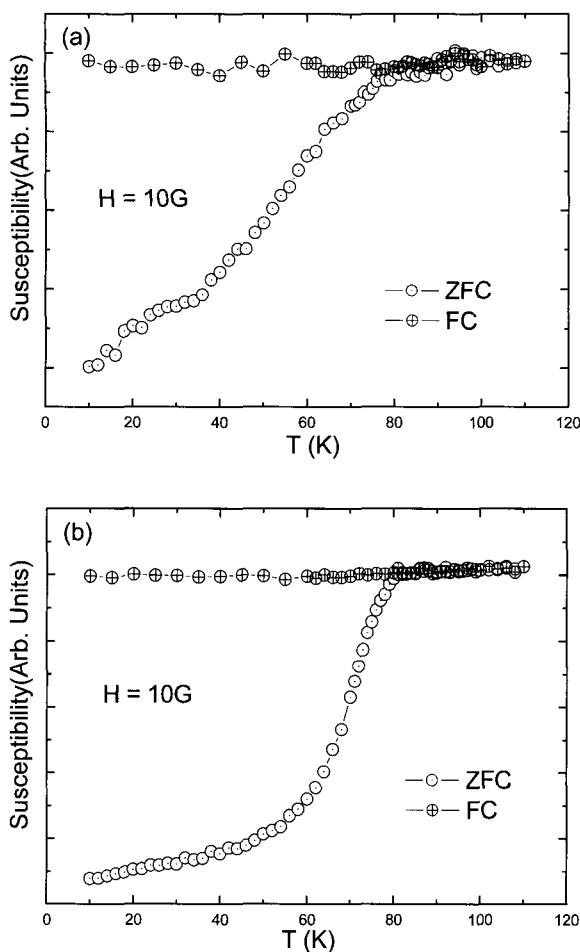


Fig. 4. DC Susceptibility of 0.74 mm diameter B wire as a function of  $T_{\max}$  (a)  $T_{\max} = 882 \text{ } ^\circ\text{C}$  (b)  $T_{\max} = 890 \text{ } ^\circ\text{C}$ .

#### IV. Conclusion

385심의 Bi2212/Ag 선재를 PIT법으로 제조하고 최대온도( $T_{\max}$ )를  $882 \sim 896 \text{ } ^\circ\text{C}$ 로 달리하여 4.2 K, 0 T에서 특성을 평가한 결과 아래와 같은 결론을 얻었다.

- (1)  $T_{\max}=888 \text{ } ^\circ\text{C}$ 에서 열처리된 0.81 mm dia. 선재가  $221,800 \text{ A/cm}^2$ 의  $J_c$ 와 244 A의  $I_c$ 를 나타내었다.
- (2) 평균필라멘트 직경  $18.8 \sim 16.3 \mu\text{m}$ 의 선재가 평균필라멘트 직경  $33.4 \sim 25.5 \mu\text{m}$ 의 선재보다 높은  $J_c$ 를 나타내었다.

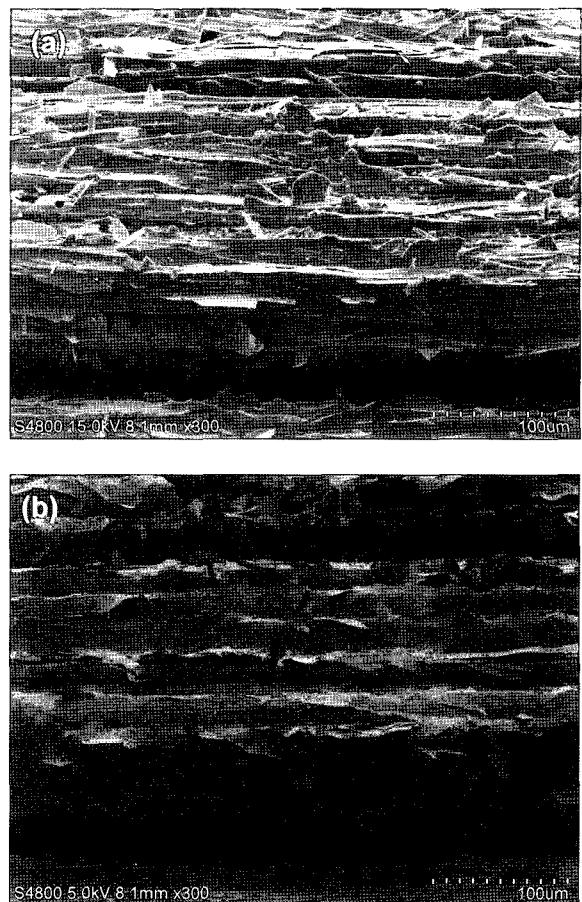


Fig. 5. SEM images of (a)  $T_{\max} = 882 \text{ } ^\circ\text{C}$  and (b)  $T_{\max} = 890 \text{ } ^\circ\text{C}$  of 0.74 mm diameter B wire(Longitudinal cross section of 1st bundle filament with Ag etched off).

(3) DC susceptibility로  $T_c$ 를 측정한 결과  $T_{\max}$ 가  $888 \text{ } ^\circ\text{C}$ 일 때  $T_c$ 가 85 K로서 가장 높은 값을 나타내었다.

#### Acknowledgments

본 연구는 산업자원부 전력산업연구개발 사업의 연구비 지원에 의해 수행되었습니다.

#### References

- [1] H. Miao, H. Kitaguchi, H. Kumakura, K. Togano, T.

- Hasegawa, and T. Koizumi, "Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>x</sub>/Ag multilayer tapes with J<sub>c</sub>>500000 A/cm<sup>2</sup> at 4.2 K, 10 T by using pre-annealing and intermediate rolling process", *Physica C*, 303, 81-90 (1998).
- [2] P. F. Hermann, J. Bock, C.-E. Bruzek, C. Cottevieille, G. Duperray, J. Hascicek, D. Legat, A. Leriche, T. Verhaege, and Y. Parasie, *Supercond. Sci. Technol.*, 13, 477 (2000).
- [3] C.-E. Bruzek, N. Lallouet, E. Flahaut, D. Bourgault, J.-M. Saugrain, A. Allais, S. Arac, J. Bock, J. Ehrenberg, D. E. Wesolowski, and M. O. Rikel, "High-performance Bi2212/Ag tape produced at NEXANS", presentation at EUCAS 2003.
- [4] H. Miao, K. R. Marken, M. Meinesz, B. Czabaj, and S. Hong, "Development of Round Multifilament Bi-2212/Ag Wires for High Field Magnet Applications", *IEEE Trans. Appl. Supercond.*, 15, 2554-2557 (2005).
- [5] H. Miao, K. R. Marken, M. Meinesz, B. Czabaj, S. Hong, M. O. Rikel, and J. Bock, "Studies of precursor composition effect on J<sub>c</sub> in Bi-2212/Ag wires and tapes", presentation at ICMC 2005.
- [6] M. O. Rikel, J. L. Reeves, N.A. Scarbrough, and E. E. Hellstrom, "Effect of Various Processing Variables on Grain Alignment at Bi-2212/Ag Interface", *Physica C*, 341-348, 2573-2574 (2000).